

Utilisation de modèles 3D et d'images 3D

Response ID:286 Data

1. Code pays

1. Please enter the two-letter country code corresponding to your Office or Organization.

Don't know your country code? [Please click here.](#)

US

Please enter your email address so we can contact you if we have questions about your response.

██████████

2. Questions

Cette enquête a été approuvée par le Comité des normes de l'OMPI (CWS) à sa septième session, afin de collecter des informations sur les pratiques et les attentes des offices de propriété intellectuelle et des utilisateurs (déposants) concernant l'utilisation de la 3D.

[PROJET DE QUESTIONNAIRE SUR L'UTILISATION DE MODÈLES 3D ET D'IMAGES 3D DANS LES DONNÉES ET DOCUMENTS RELATIFS À LA PR](#)

Glossaire

Modèle 3D – Fichier électronique créé par un logiciel spécialisé pour représenter mathématiquement la surface d'un objet en trois dimensions.

Images 3D – Images représentant des objets en trois dimensions (largeur, profondeur, hauteur), par exemple, photos 3D, stéréoscopie, etc.

3DS – Format de fichier utilisé par 3ds Max, le logiciel de modélisation, d'animation et de rendu 3D d'Autodesk.

DWF – Design Web Format.

DWG – Format de fichier dont l'utilisation est très répandue pour les dessins CAO.

IGES – Initial Graphics Exchange Specification.

OBJ – Format de fichier ouvert contenant la description des données géométriques d'un modèle 3D, utilisé en CAO et en impression 3D.

Image matricielle – Image constituée d'une matrice de points (pixels), désignée sous le nom de "carte de points". Les formats de fichier usuels pour les images matricielles sont JPEG, TIFF, PNG et BMP.

STL (Standard Tessellation Language) – Format de fichier utilisé dans les logiciels CAO de stéréolithographie, créé par 3D Systems.

STEP – Norme pour l'échange de données sur les modèles de produits – norme ouverte élaborée par l'ISO portant sur la représentation d'objets 3D en conception assistée par ordinateur (CAO) et de l'information associée.

Image vectorielle – Fichier d'image composée de formes constituées de formules et coordonnées mathématiques sur une surface 2D. Contrairement aux images matricielles, les images vectorielles peuvent être redimensionnées à l'infini sans perte de qualité.

X3D – Format ouvert en XML normalisé par l'ISO, ayant succédé à VRML.

Partie 1. Objets de propriété intellectuelle et stades de leur cycle de vie

2. 1.1. Votre office utilise-t-il actuellement des modèles 3D ou des images 3D pour les objets de propriété intellectuelle ? Si oui, pour quels objets ?

Marques

Autre (veuillez préciser): Trademarks Office currently accepts 3D images and stores as 2D image. The Description of Mark references the mark as 3D. Design Patents- Other (please specify): We have interpreted the definitions in this survey to mean that "3D images" encompasses mathematical models that can be virtually manipulated in three dimensions, such as CAD drawings. For design patent applications, USPTO only accepts static 2D image files which may convey 3D features through the use of, for example, shading and perspective.

3. 1.2. Votre office envisage-t-il d'utiliser à l'avenir des modèles 3D ou des images 3D pour les objets de propriété intellectuelle ? Si oui, pour quels objets ?

Autre (veuillez préciser): Design Patents- Other (please specify): The USPTO's existing plans for 3D models and 3D images include permitting exhibition or demonstration of such by applicants during examiner interviews, per MPEP 713.08. Future plans include studying 3D models and 3D images as they pertain to patent applications. Trademarks Office may consider using 3D images for IP objects in the future. The Office has not determined which IP object to be considered 3D images.

4. 1.3. Actuellement, à quels stades du cycle de vie des objets de propriété intellectuelle votre office accepte-t-il/exploite-t-il des modèles 3D ?

	Dépôt de la demande	Examen	Stockage	Recherche	Publication	Échange de données	Autre (veuillez préciser en commentaire)
Marques							
Dessins et modèles industriels							
Brevets dans le domaine de la chimie en tant que technologie (par exemple, structures chimiques, structures biologiques)							
Brevets dans d'autres domaines technologiques (par exemple, génie électrique, génie mécanique, etc.)							
Topologie de circuit imprimé							

Commentaire: Under the interpretation that "accept/implement" means "formally enter into an application file wrapper", USPTO does not accept or implement 3D models at any of the listed stages for design patent applications. Integrated Circuit Topology (mask works) is covered by the Semiconductor Chip Protection Act ("SCPA") of 1984, 17 U.S.C. §§ 901-14. TM is only accepting 2D image. However, the Description of Mark can describe the 3D image of the Mark.

5. 1.4. Votre office procède-t-il à des transformations d'image ? Si oui, pour quels objets et à quels stades ?

	Dépôt de la demande	Examen	Stockage	Recherche	Publication	Échange de données	Autre (veuillez préciser en commentaire)
Marques							
Dessins et modèles industriels							
Brevets dans le domaine de la chimie en tant que technologie (par exemple, structures chimiques, structures biologiques)							
Brevets dans d'autres domaines technologiques (par exemple, génie électrique, génie mécanique, etc.)							
Topologie de circuit imprimé							

Commentaire: USPTO accepts PDF image files, which are transformed to TIFF files and used in examination, search, publication and data exchange systems. The originally submitted PDF image file is also available for examiners and the public. USPTO receives JPEG image files for Hague applications, which are transformed to PDF files. These files are used in examination. The files are transformed to TIFF images for search, publication and data exchange. The originally submitted JPEG and PDF image files are also available for examiners and the public to view. Trademarks does not currently conduct any transformations of image files.

6. 1.5. À quels stades du cycle de vie des objets de propriété intellectuelle votre office envisage-t-il d'accepter/d'exploiter des modèles 3D à l'avenir ?

	Dépôt de la demande	Examen	Stockage	Recherche	Publication	Échange de données	Ne sait pas	Autre (veuillez préciser en commentaire)
Marques								
Dessins et modèles industriels								
Brevets dans le domaine de la chimie en tant que technologie (par exemple, structures chimiques, structures biologiques)								
Brevets dans d'autres domaines technologiques (par exemple, génie électrique, génie mécanique, etc.)								
Topologie de circuit imprimé								

Commentaire: USPTO continues to study 3D models and 3D images in reference to patent applications and monitor progress in this area. At this point, TM is not sure when TM will start accepting 3D images and in what format. TM will continue allowing applicants to describe the 3D mark.

Partie 2. Pratiques existantes et projets

7. 2.1. Veuillez décrire les pratiques existantes/projets relatifs à l'utilisation de modèles 3D et d'images 3D dans votre office.

USPTO's existing plans for 3D models and 3D images include permitting exhibition or demonstration of such by applicants during examiner interviews, per MPEP 713.08. Future plans include studying 3D models and 3D images as they pertain to patent applications. The current practice at TM for 3D image is required to describe the 3D image in the Description of Mark field. Submit 2D image.

Partie 3. Réglementation

8. 3.1. Veuillez indiquer quelle législation et quelles réglementations sont appliquées dans votre ressort juridique, pour les modèles 3D et images 3D.

37 CFR 1.91- 37 CFR 1.91 Models or exhibits not generally admitted as part of application or patent.

MPEP 608.03(a)- 608.03(a) Handling of Models, Exhibits, and Specimens [R-07.2015]

MPEP 713.08- 713.08 Demonstration, Exhibits, Models [R-07.2015]

TM has not accepted 3DM images so therefore there is no laws or regulations. Guidance on examining 3D image has issued.

Partie 4. Formats et outils techniques

9. 4.1. Quels formats de modèles 3D ou d'images 3D votre office utilise-t-il actuellement? Utilise-t-il les mêmes formats ou des formats différents aux différents stades du cycle de vie : dépôt, examen, publication, etc. ?

N/A - For design patent applications, USPTO only accepts static 2D image files

10. 4.2. . Quels formats de modèles 3D ou d'images 3D votre office envisage-t-il d'utiliser à l'avenir? Envisage-t-il d'utiliser les mêmes formats ou des formats différents aux différents stades du cycle de vie : dépôt, examen, publication, etc. ?

USPTO has not determined the format. Hopefully, 3D model and 3D image standard can provide a format that can be used across the board.

11. 4.3. Veuillez nous communiquer vos suggestions et propositions concernant les formats et les raisons pour lesquelles vous supposez que ceux-ci sont importants (liste de formats à envisager), à l'exclusion des éléments cités aux points 6.1 et 6.2.

N/A

12. 4.4. Quels outils techniques votre office utilise-t-il actuellement pour travailler avec des modèles 3D (outils de visualisation, convertisseurs, etc.)? S'agit-il d'outils standard disponibles dans le commerce ou envisagez-vous d'utiliser un outil spécial mis au point pour ou par votre office ?

N/A

13. 4.5. Quels outils techniques votre office envisage-t-il d'utiliser à l'avenir pour travailler avec des modèles 3D (outils de visualisation, convertisseurs, etc.)? S'agit-il d'outils standard disponibles dans le commerce ou envisagez-vous d'utiliser un outil spécial mis au point pour ou par votre office ?

N/A

14. 4.6. Veuillez nous communiquer vos suggestions et propositions concernant les outils et les raisons pour lesquelles vous supposez que ceux-ci sont importants (liste d'outils à envisager)

N/A

Partie 5. Exigences et limites particulières

15. 5.1. Veuillez nous faire part de vos exigences concernant les fichiers spécifiques souhaitables. Ces fichiers devraient-ils être identiques ou différents pour les différents objets et stades (limites et restrictions pour les fichiers 3D, taille (Mo) et format du modèle 3D pour stockage, traitement et partage, etc.) ?

N/A

16. 5.2. Quelles seraient selon vous les principales exigences lors du choix de formats de fichier 3D (formats ouverts, adoption généralisée, etc.) ?

For TM, In my opinion, the main requirement shall be adaptable and widely supportable

17. 5.3. Quelles seraient selon vous les principales exigences lors du choix d'outils pour travailler avec des fichiers 3D ?

For TM, In my opinion, the requirement for tool shall be free for viewing, backward compatible, open source for editing.

Partie 6. Attentes concernant l'utilisation de la 3D

18. 6.1. Quels sont les avantages ou les inconvénients spécifiques que les modèles 3D et les images 3D peuvent présenter en ce qui concerne la recherche, par exemple, la recherche sur l'état de la technique ?

N/A

19. 6.2. Vous attendez-vous à ce que les déposants fournissent des modèles 3D conformes aux normes définies ?

N/A

Partie 7. Autre

20. 7.1. Avez-vous d'autres commentaires ?

None

3. Vérification

You have reached the end of the survey questions. Your answers have been saved.

If you or your colleagues wish to revise your answers later, you can use the link emailed to you with the Save and Continue option in the top right of this page. The Review or Back button below will return you to your answers.

When you are ready to submit your final answers, click the Submit button below. You will no longer be able to edit your responses after clicking Submit.

Vous pouvez télécharger une copie de vos réponses:

4. Merci !

Merci d'avoir répondu à l'enquête.